

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 6 月 21 日(21.06.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/081705 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 65/48 (2006.01) *C08F 283/06* (2006.01)
B32B 17/04 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)
C08F 2/44 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/079229
- (22) 国際出願日: 2011 年 12 月 16 日(16.12.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-280500 2010 年 12 月 16 日(16.12.2010) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 旭化成イーマテリアルズ株式会社(Asahi Kasei E-materials Corporation) [JP/JP]; 〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 0 5 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 常盤 哲司(TOKIWA, Tetsuji) [JP/JP]; 〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 0 5 番地 Tokyo (JP). 内海 貴光(UTSUMI, Takamitsu) [JP/JP]; 〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 0 5 番地 Tokyo (JP). 遠藤 正朗(ENDO, Masaaki) [JP/JP]; 〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 0 5 番地 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: CURABLE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 硬化性樹脂組成物

(57) Abstract: Provided is a curable resin composition which can provide a cured article having a low dielectric constant and a low dielectric tangent, and can also provide a cured article having excellent moldability at ordinary press-molding temperatures, excellent heat resistance and excellent adhesion properties. The present invention provides a curable resin composition containing a polyphenylene ether, wherein the average number of phenolic hydroxy groups is 0.3 or more per molecule of the polyphenylene ether, the resin flow amount of the curable resin composition upon curing is 0.3 to 15% inclusive, and a cured article having a dielectric tangent of 0.005 or less at 1 GHz and a glass transition temperature of 170°C or higher can be produced.

(57) 要約: 低い誘電率及び誘電正接を有する硬化物を与え、通常のプレス成形温度での成形性に優れ、更には優れた耐熱性及び接着性を有する硬化物を与える硬化性樹脂組成物を提供する。本発明は、ポリフェニレンエーテルを含む硬化性樹脂組成物であって、該ポリフェニレンエーテル 1 分子当たりの平均フェノール性水酸基数が 0.3 個以上であり、該硬化性樹脂組成物の硬化時樹脂フロー量が 0.3 % 以上 15 % 以下であり、かつ 1 GHz での誘電正接: 0.005 以下、及びガラス転移温度: 170°C 以上を有する硬化物を与える、硬化性樹脂組成物を提供する。

WO 2012/081705 A1